

特点

- 小封装尺寸可用于高密度装配 .
- 玻璃密闭封装 .
- 良好地适用于自动装配 .
- 采用无铅工艺合乎 RoHS 指令要求 .

封装外形尺寸

MiniMELF (SOD-80)

尺寸单位 : mm

机械数据

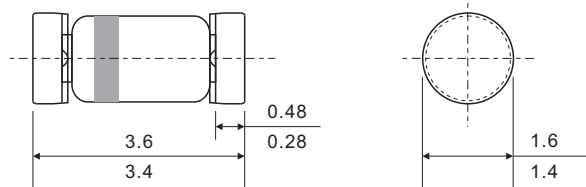
封装 : miniMELF (SOD-80) 玻璃封装

引脚易焊性标准 : GB4937-1995
GB2423.28-82

极性 : 色环标志负极 .

安装位置 : 任意 .

重量 : 约 0.03 克



绝对最大额定值 $T_{amb} = 25^{\circ}C$ 除非特别注明

| 参数项目 | 测试条件 | 符号 | BAV100 | BAV101 | BAV102 | BAV103 | 单位 |
|--------------|--------------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|----|
| 重复反向峰值电压 | | V_{RRM} | 60 | 120 | 200 | 250 | V |
| 恒定 (直流) 反向电压 | | V_R | 50 | 100 | 150 | 200 | V |
| 正向平均整流电流 | 阻性负载半波整流 * $f \geq 50Hz$ | I_o | 250 | | | | mA |
| 峰值正向浪涌电流 | $t < 1 s, T_j = 25^{\circ}C$ * | I_{FSM} | 1 | | | | A |
| 耗散功率 | $T_L \leq 25^{\circ}C$ | P_{tot} | 500 | | | | mW |

* 器件焊于FR4印刷线路板上。

热特性 $T_{amb} = 25^{\circ}C$ 除非特别注明

| 参数项目 | 测试条件 | 符号 | 数值 | 单位 |
|-----------|------------------------|------------|------------|-----------------|
| 热阻 (结至环境) | $T_L=25^{\circ}C$ 恒温 * | R_{thJA} | 350 | $^{\circ}C / W$ |
| 最高容许结温 | | T_j | 175 | $^{\circ}C$ |
| 贮存温度范围 | | T_{stg} | - 65 ~ 175 | $^{\circ}C$ |

* 器件焊于FR4印刷线路板上。

电特性 $T_{amb} = 25^{\circ}C$ 除非特别注明

| 参数项目 | 测试条件 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|----------------|---|-----------|-----|-----|-----|---------|
| 正向电压 | $I_F = 100 mA$ | V_F | — | — | 1 | V |
| 反向漏电流@额定 V_R | $T_A = 25^{\circ}C$ | I_R | — | — | 100 | nA |
| | $T_A = 150^{\circ}C$ | I_R | | | 100 | μA |
| 结电容 | $V_R = 0, f = 1MHz$ | C_{tot} | | | 5 | pF |
| 反向恢复时间 | $I_F = I_R = 30 mA$ $i_R = 0.1 \times I_R, R_L = 100 \Omega$ | t_{rr} | — | — | 50 | ns |

额定值及电特性参数曲线 $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ 除非特别注明

图1 最大允许正向连续电流对环境温度

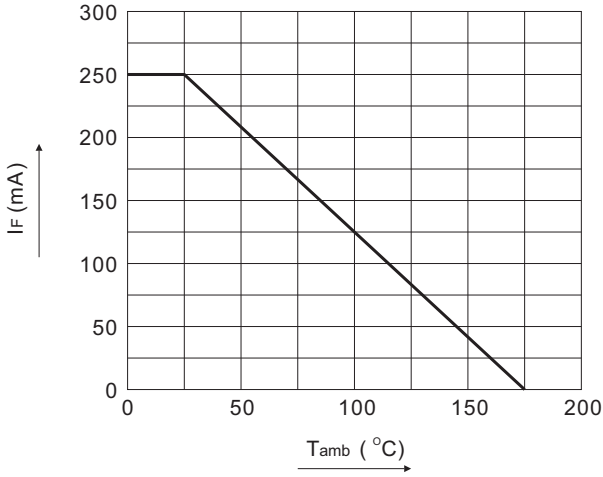


图2 瞬间正向特性曲线

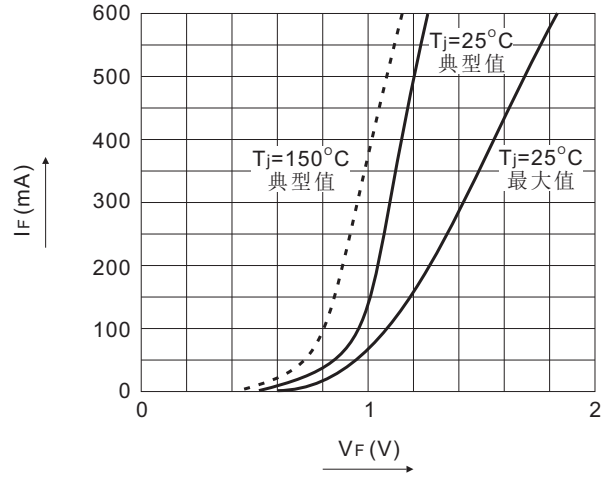


图3 最大允许连续反向电压对环境温度

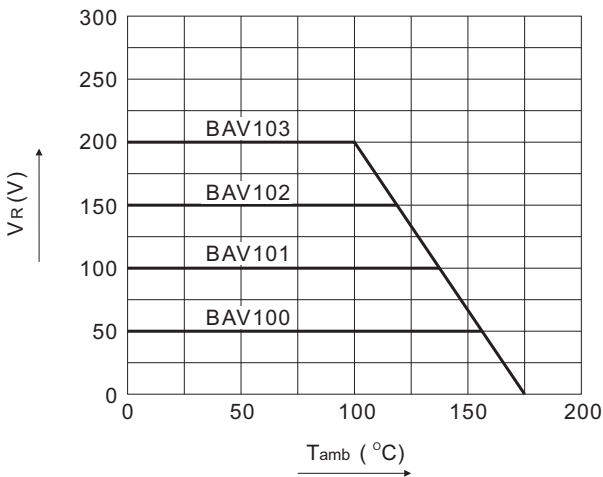


图4 电容比值对反向电压

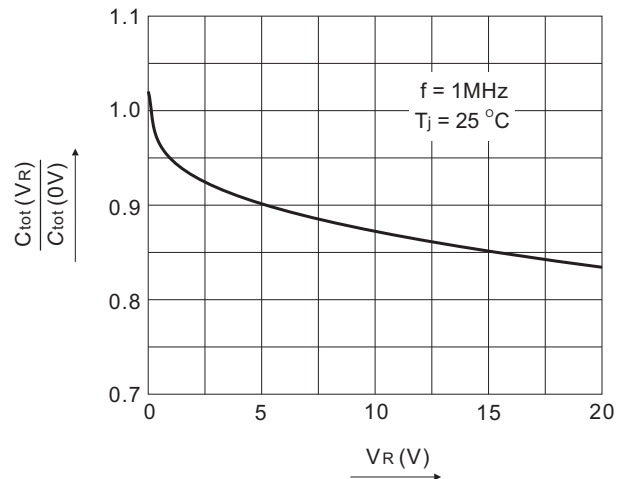
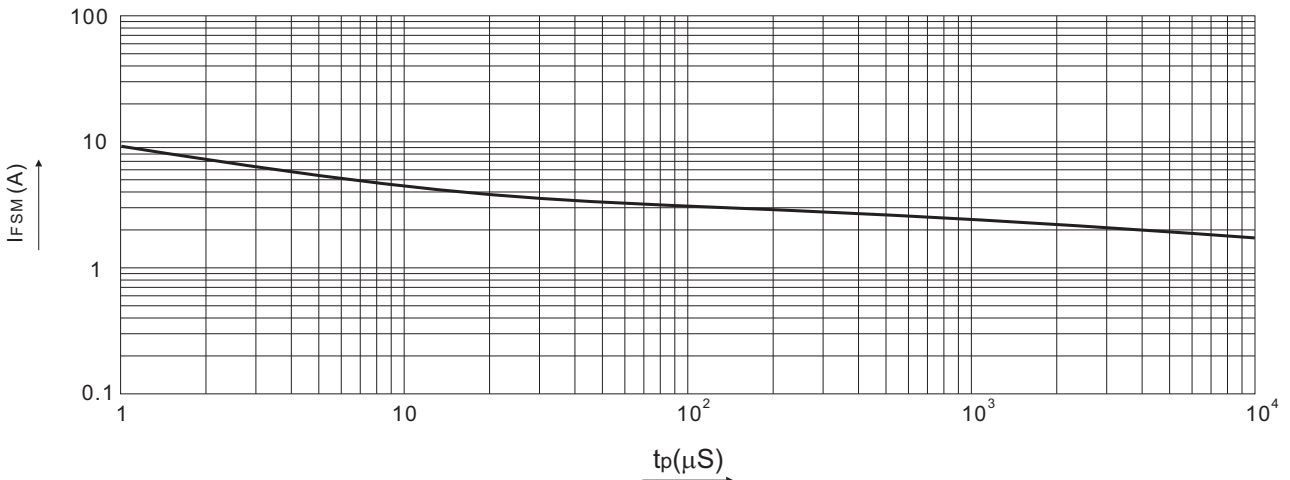


图6 容许重复峰值正向电流对脉冲宽度



额定值及电特性参数曲线 $T_{amb} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ 除非特别注明

图5 反向漏电流对结温

